



特性

- 》高的热传导率
- 》良好的柔软性和填充性
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性，易于安装操作
- 》低介电常数，有效降低信号损耗

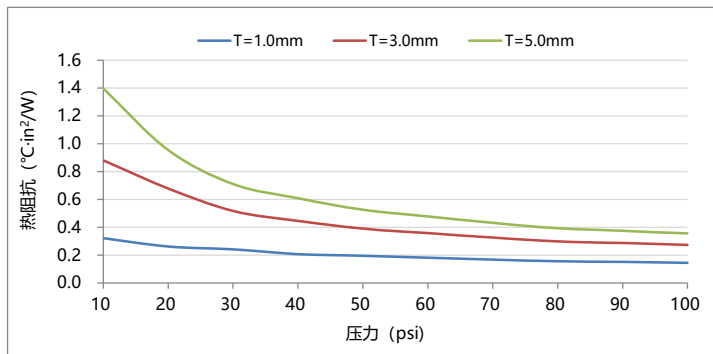
应用

- 》毫米波雷达
- 》半导体微波组件
- 》5G基站
- 》射频功率放大器
- 》高性能计算

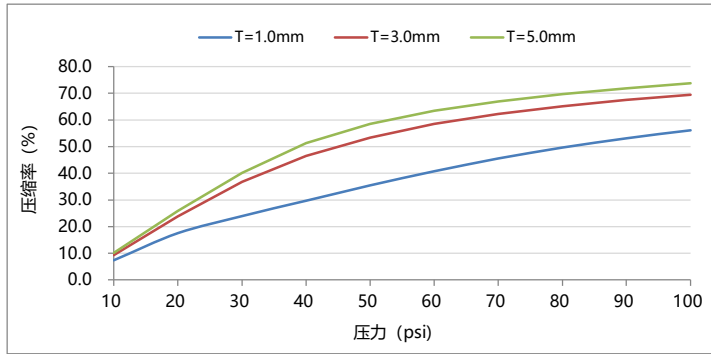
TIF®100N-50-10F 一款低介电导热垫片，针对高频、高集成、信号敏感类电子设备研发的柔性导热绝缘材料，提供了良好导热能力和适中的硬度，这种平衡的设计使其兼具良好的表面贴合能力与优异的操作便利性，兼顾良好散热与低介电电气特性，适配精密电子设备的热管理与信号传输双重需求，性能稳定、实用性强。

TIF® 100N-50-10F 系列特性表			
产品特性	典型值		测试方法
颜色	灰色		目测
结构&成份	氮化硼填充硅橡胶		-
厚度范围 (inch/mm)	0.010~0.020 0.25~0.50	0.030~0.200 0.75~5.00	ASTM D374
硬度 (Shore OO)	65	55	ASTM D2240
密度 (g/cm³)	3.0		ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 200		-
击穿强度 (V/mm)	≥5500		ASTM D149
介电常数 @1MHz	4.7		ASTM D150
体积电阻率 (Ohm-cm)	> 1.0×10 ¹²		ASTM D257
导热系数 (W/m·K)	5.0		ASTM D5470
	5.0		ISO22007
阻燃等级	V-0		UL94 (E331100)

热阻抗



压缩率



产品规格

标准厚度: 0.010" (0.25 mm) ~ 0.200" (5.00 mm)，以 0.010" (0.25 mm) 为增量。
标准尺寸: 16"×16" (406 mm×406 mm)

TIF®系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系

产品型号说明

TIF1 00 N 50 - 10F

- 颜色: 10 (灰色) & 硬度: 55
- 导热系数: 5.0 W/m·K
- 低介电
- 厚度: 10 mils~200 mils
- 产品系列

全球方案：在地服务

中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859

service@ziitek.com
www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科技术有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIF100N-50-10F-0626